

MEDIUM LEVEL - PROGRAM v120522

total time	delay		topic	téma	lecturer
celk. čas	pooba[min]	[min]	theroretical part	teoretická část	řednášející
1:00	60	20	PCB's defects, HDI PCB's, substrates, properties	Defekty DPS, HDI DPS, zákl. materiály, vlastnosti	ST
		20	Chemistry in the process, LF vs L chemistry	Chemie v montážním procesu, rozdíly LF vs. L	ST
		20	Cleaning, requirements and aspects	Čištění, požadavky	ST
1:30	30	30	Aplication technology, printing, dispensing Main process parameters for quality	Aplikační technologie, tisk, dispense Hlavní procesní parametry pro dosažení kvality	ST
1:40	10	10	BREAK	PRESTAVKA	
3:10	90	90	SMD II	SMD II	SA / MA
			SMD defects ESD, MSD	SMD defekty ESD, MSD	
			BREAK - LUNCH	PRESTAVKA NA OBED	
4:25	45	45	Solder joint reliability - factors	Spolehlivost pájeného spoje - faktory	ST
			Lead free soldering and process change	Bezolovnaté pájení a změna procesu	
			Manual, wave, reflow - process parameters for quality	Pájení ruční, vlnou, přetavením -procesní parametry	
4:45	20	10	TEST	TEST	ST, SA / MA
		10	Discussion	Diskuse	ST, SA / MA
4:55	10	10	BREAK	PRESTAVKA	

MEDIUM LEVEL - PROGRAM

total time	delay		topic	téma	lecturer
celk. čas	pooba[min]	[min]	practical part	praktická část	řednášející
7:00	125	125	BGA reballing	Reballing pouzder BGA	SA
			Soldering, desoldering of BGA packages	Pájení a odpájení pouzder BGA (elektrická kontrola)	
			Solder joint reliability (demonstration)	Spolehlivost pájeného spoje (ukázky)	
8:30	90	90	Wetting balance test method	Metoda smáčecích vah	ST
			Practical test of wettability THT leads	Praktické testy smáčivosti vývovů THT součástek	
			Evaluation, discussion	Hodnocení, diskuse	
			COURSE CLOSING	ZAKONČENÍ KURZU	

